

第三弾 『日本版シリコンバレー創出に向けてー
深圳に学ぶエコシステム型イノベーション』（ナカニシヤ出版）
発刊記念セミナー第3回

自動車用チップ不足を手掛かりに日本の半導体産業を考える ～New Opportunities、New Challenges～

2月24日（水）1930-2100 Zoomミーティングに参加する

<https://us02web.zoom.us/j/88217290974?pwd=cXBha2lSczNPQWxxVk44cDlyZktKdzog>

ミーティングID: 882 1729 0974

パスコード: 682115



主催団体：日中イノベーションプラットフォーム推進会

プログラム

- 19:30-19:32 第三弾 出版記念セミナー企画趣旨、会の進行お願い事項
- 19:32-20:10 基調講演 「日本の半導体産業：過去の経験から未来を考える（仮題）」豊崎禎久
(アーキテクトグランドデザイン（株）ファウンダー）
- 20:10-20:50 パネルディスカッション テーマ「自動車CASEと通信・AIから半導体産業を展望する：その可能性と課題（仮題）」
- モデレーター 金 堅敏（富士通 グローバル戦略企画部門 チーフデジタルエコノミスト）
- パネラー 野辺 継男（米インテル ディレクター及びチーフサービスアーキテクト（兼）名古屋大学 客員准教授）
豊崎禎久（アーキテクトグランドデザイン（株）ファウンダー）
郭 宇（華為技術日本株式会社 技術戦略本部 シニアディレクター）

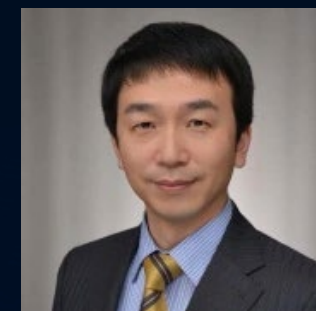


豊崎禎久
アーキテクトグランドデザイン株式会社 Founder & Chief Architect
•ニッポンハイテク再成長させる会 主宰
•一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会 専務理事
•前慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 特別招聘教授

野辺 継男



郭 宇



金 堅敏

